

SOITEC ET SHIN-ETSU HANDOTAI ANNONCENT UNE EXTENSION DE LA LICENCE SMART CUTTM ET UNE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE ACCRUE

Ce nouvel accord élargit la chaine d'approvisionnement de plaques de SOI pour répondre à la demande croissante du marché pour les applications grand public

Bernin (France), le 9 octobre 2012 - Soitec (Euronext), leader mondial de la génération et de la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances pour l'électronique et l'énergie, et Shin-Etsu Handotai Co., Ltd (SEH), premier fabricant mondial de plaques de silicium, annoncent aujourd'hui une extension de la licence Smart CutTM et une coopération technologique accrue. En étendant à dix années supplémentaires leur accord de licence, les deux entreprises franchissent ainsi un nouveau cap de coopération technologique. Cet accord facilitera le développement et la chaîne d'approvisionnement de plaques de SOI (silicium sur isolant) pour répondre aux opportunités de marché que représentent les dispositifs RF, les circuits FinFETs sur SOI et les circuits planaires FD « Fully Depleted » (ou « totalement déplétée »). Les deux entreprises vont être capable d'augmenter la production mondiale de plaques SOI au moment où la demande dans l'industrie électronique explose due à l'augmentation du nombre des composants mobiles et d'informatique embarquée dans le marché grand public. Cet accord représente une étape importante dans le développement de la chaîne d'approvisionnement et de l'écosystème. Il permettra que la nouvelle génération de plaques de SOI soit fournie par deux entreprises indépendantes, collaborant au niveau de la R&D, et que les délais de commercialisation des matériaux avec des avancées majeures puissent être réduits.

La technologie Smart Cut de Soitec est le standard de l'industrie pour la fabrication de plaques de SOI. L'accord annoncé ce jour est une extension de licence qui élargit le périmètre du partenariat entre Soitec et SEH, avec notamment la concession de licences croisées pour les brevets relatifs à la technologie Smart Cut entre les deux sociétés. Grâce à cet accord, SEH continuera à utiliser la technologie Smart Cut de Soitec, pour fabriquer des plaques de SOI. SEH pourra également étendre ses capacités de production à partir de cette technologie Smart Cut à de nouveaux matériaux. En évoluant vers ce que l'on appelle communément « Silicium sur tout support » ou SOA - Silicon on Anything (désignant tout matériau à la surface duquel est formé une mince couche de silicium), SEH pourra élargir davantage le champ de ses applications.

« Nous nous réjouissons des opportunités commerciales qui s'offrent aux produits SOI et sommes impatients de collaborer avec Soitec pour étendre la chaîne d'approvisionnement mondiale à de nouveaux produits comme le FD-SOI et le SOI pour FinFET, qui ont démontré leur potentiel en termes d'avantages pour les applications mobiles et embarquées », a déclaré Nobuo Katsuoka, directeur du programme SOI de SEH. « Les relations que nous entretenons

avec Soitec ont toujours été positives et fructueuses, et nous nous félicitons d'étendre cette collaboration. Les caractéristiques uniques de la technologie Smart Cut permettront à nos deux entreprises d'augmenter ensemble la production mondiale de produits SOI existants et nouveaux».

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec SEH », a déclaré Paul Boudre, Directeur général délégué de Soitec. « Nous collaborons avec cette société depuis quinze ans et nous avons imposé ensemble la technologie Smart Cut comme la référence de l'industrie pour la fabrication de plaques SOI. En étendant notre coopération, nous entendons fabriquer de nouveaux produits tels que des plaques SOI totalement déplétées (FD-SOI) et des plaques SOI pour la technologie FinFET. Cette période est critique pour l'industrie électronique, qui a de plus en plus besoin de nouveaux matériaux innovants permettant d'augmenter les performances et le rendement énergétique des appareils grand public que nous utilisons au quotidien. Ensemble, Soitec et SEH fourniront les matériaux de pointe dont l'industrie électronique a besoin pour continuer à innover».

A propos de Smart Cut:

Smart Cut, le standard de l'industrie est la technologie d'ingénierie des matériaux propriétaires de Soitec. La technologie révolutionnaire de collage de plaques et de procédés de transfert de couches permet le transfert de fines couches d'un substrat donneur à un substrat support. En surmontant les limites physiques classiques, cette technologie a modifié le visage de l'industrie des substrats.

Shin-Etsu Handotai a été la première société à acquérir la licence de la technologie Smart Cut et à signer une alliance à long terme avec Soitec en 1997. Aux termes de cet accord, Soitec a octroyé à SEH une licence l'autorisant à utiliser la technologie Smart Cut pour fabriquer et commercialiser des plaques de SOI. La technologie Smart Cut a été initialement développée par le CEA-Léti, l'un des premiers laboratoires de recherche en microélectronique au monde. Soitec a acquis l'exploitation exclusive de cette technologie et peut autoriser SEH à l'utiliser. Cette technologie, dont la production en volume a été rendue économiquement viable par Soitec, est à présent protégée par plus de 3 000 brevets détenus ou contrôlés par Soitec.

A propos de Soitec :

Soitec (Euronext, Paris) est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de métier est la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances. Ses produits, des substrats pour circuits intégrés (notamment à base de SOI - Silicium On Insulator) et des systèmes photovoltaïques à concentration (CPV), ses technologies Smart CutTM, Smart StackingTM et ConcentrixTM ainsi que son expertise en épitaxie en font un leader mondial. Soitec relève les défis de performance et d'efficacité énergétique pour une large palette d'applications destinées aux marchés de l'informatique, des télécommunications, de l'électronique automobile, de l'éclairage et des centrales solaires à forte capacité. Soitec a aujourd'hui des implantations industrielles et des centres de R&D en France, à Singapour, en Allemagne et aux Etats-Unis. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.com.

Relations investisseurs

Olivier Brice, Soitec CFO +33 (0)4 76 92 93 80 olivier.brice@soitec.com

Contact Presse française

Marie-Caroline Saro, HB Communication +33 (0)1 58 18 32 44 mc.saro@hbcommunication.fr

#